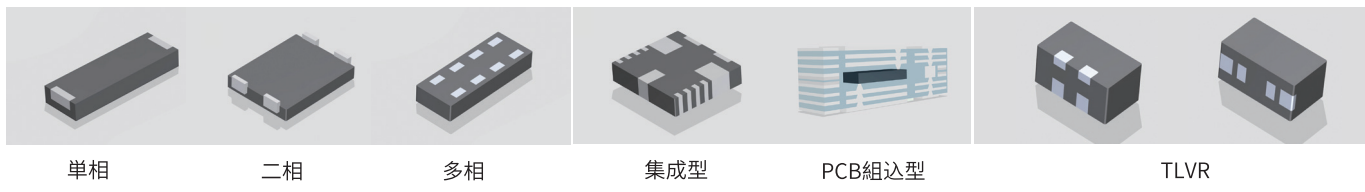


POCO は会社の創立以来継続して金属の軟磁材料の研究開発・設計・製造に専念しています。材料についての深い研究とプロセス技術の継続的な改良に基づいて、POCO は銅と鉄の共焼プロセス (CFS) を開発し、高圧成形技術を組み合わせて次世代チップインダクタを発表しました。そして、2023 年に子会社 NI を創立しました。

【NI】はハイエンドインダクタのプラットフォームを構築し、高効率、小型、高信頼性の高出力インダクタを提供することで、AI サーバー、コンピュータ、自動車、通信などの市場に貢献しています。現在、複数の国際的に有名なチップメーカーの承認を得ており、多くのハイエンドの AI チップに採用されています。

製品




製品仕様

周波数	200k ~ 5 MHz
電流	40 ~ 150 A
インダクタンス	10 ~ 300nH (300nH ~ 2μH 開発中)
寸法	L&W:1.5 ~ 15mm / H:1 ~ 8 mm
材料	FF, FA, XA, XF, GA
形状	

標準ラインナップ

製番	DCR (mΩ)	Irms (A)	寸法 (mm ³)
R12	0.33	50	9.0*4.0*2.8 10.6*5.3*3.0 11.0*7.0*3.0 12.0*5.5*3.0 14.0*10.0*2.1 14.2*5.0*3.0
R15	0.33	50	
R18	0.42	45	
R20	0.52	40	
R22	0.75	35	
R27	1.1	30	

メリット



50%~75%の体積を減らす

フェライト

CFS

大電流
小型
高効率
高放熱性

応用

AIサーバー
自動車
GPU, CPU, ASICs

